

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2026年1月19日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	见附件
会议时间	2026年1月19日 15:00-18:00
会议地点	佰维存储惠州封测制造中心二楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司管理层 董办工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1. 公司的晶圆级先进封测制造项目目前建设进度如何？规划的产能规模多大？预计何时可以贡献收入？ A1: 公司位于东莞松山湖的晶圆级先进封测制造项目整体进展顺利，目前正按照客户需求推进打样和验证工作。公司预计 2026 年底晶圆级先进封测制造项目月产能将达到 5000 片，预计 2027 年底月产能将达到 1 万片，并预计将于 2026 年年底开始贡献收入，能够为客户提供“存储+晶圆级先进封测”一站式综合解决方案，进一步提升公司在存算整合领域的核心竞争力。</p> <p>Q2. 公司如何看待当前存储行业景气度的持续性？目前存货情况如何？ A2: NAND Flash 方面，TrendForce 集邦咨询预测产品价格将在 2026 年第一季度持续上涨 33-38%。DRAM 方面，TrendForce 集邦咨询预测一般型 DRAM 价格在 2026 年第一季度继续上涨 55-60%。目前存储价格持续回升，叠加 AI 眼镜等新兴应用需求旺盛，从当前时点来看，景气度仍会持续。公司积极备货，目前库存较为充足。</p> <p>Q3. 公司的晶圆级先进封测制造项目构建了哪些技术能力与产品线？ A3: 公司已构建覆盖 Bumping、Fan-in、Fan-out、RDL 等晶圆级先进封装技术，目前主要规划两大类产品线，分别是应用于先进存储芯片的 FOMS 系列，以及先进存算合封 CMC 系列。公司已推出使用 FOMS-R 工艺的超薄 LPDDR 产品，可应用于端侧 AI 手机，满足 AI 端侧产品对大容量存储的需求。公司 CMC 产品包含“1+6”、“2+8”方案，其中“2+8”方案可支持 3.1-3.2 倍光罩尺寸，用于连接计算芯片及大容量存储。公司晶圆级先进封装技术可以满足新时代对大容量存储和存算合封的需求，主要适用于 AI 端侧（AI PC、具身智</p>

能、AR/VR 眼镜）、AI 边缘（智能驾驶等）领域。

Q4. 公司 2025 年第四季度业绩大幅增长的主要原因有哪些？

A4: SanDisk 在 2025 年 11 月发布涨价函，其 NAND 闪存合约价格大幅上调 50%，2025 年第四季度产品市场价格持续提升。存储涨价属于行业利好，公司亦受益于价格提升。同时，公司面向 AI 新兴端侧领域的高价值产品持续批量交付，公司出货产品结构持续优化，公司的营业收入和利润大幅改善。

Q5. 公司做晶圆级先进封装，与传统的封装服务相比有什么差异化竞争优势？

A5: 公司通过“高性能存储+晶圆级封测”的垂直整合能力，构建差异化竞争优势：1) 技术协同：存储芯片研发与封测技术形成双向赋能，公司拥有独立的设计仿真团队，可针对客户需求定制产品方案，缩短产品开发周期，在交期、成本上形成优势，获得客户高度认可；2) 客户协同：存储+先进封测服务在 AI 端侧、自动驾驶等领域客户重合，形成业务闭环；3) 价值提升：公司的服务模式，相较于提供单一的存储解决方案或者先进封测服务，具备综合的竞争力；公司提供的综合解决方案的价值量相比单独的先进封测服务，具有显著的放大效应。

Q6. 目前存储价格持续上涨，如何展望公司 2026 年的发展？

A6: 从当前来看，存储产品价格在 2026 年第一季度、第二季度有望持续上涨。在供应方面，公司积极备货，目前库存较为充足。公司与全球主要存储晶圆原厂继续签订 LTA（长期供应协议），公司北美客户亦积极与原厂沟通，帮助公司锁定原厂产能，有效保障关键原材料的稳定供应。在产品方面，公司预计 2026 年 AI 眼镜等高价值 AI 端侧产品将持续放量，有助于公司稳定毛利率水平；预计 2026 年智能汽车产品收入有望大幅提升。公司产品目前已进入手机、PC 领域头部客户，2026 年公司将持续提升自研主控的出货占比，为提升存储解决方案的核心竞争力提供坚实保障。

Q7. 公司先进封装的良率和毛利率能够做到多少？目前已经与哪些客户接触？

A7: 目前公司先进封装良率已达 95%以上，预计先进封装业务综合毛利率约为 30%-40%。公司技术路线在国内具有竞争优势，在存储和计算整合封测领域具备较强的竞争力，公司已与多家知名客户展开沟通，并获得认可和反馈。

Q8. 公司自研的存储测试设备具有怎样的核心竞争力？

A8: 公司在 NAND Flash 及 DRAM 存储芯片领域的 ATE 测试、Burn-in（老化）测试、SLT（系统级）测试等多个环节，拥有从测试设备硬件开发、测试算法开发以及测试自动化软件平台开发的全栈测试开发能力，并处于国内领先水平。其中，针对 Burn-in 测试环节，公司推出的创新老化测试系统，可以满足 NAND、DRAM 及 PCRAM（相变存储器）等多种存储器测试需求；针对 DRAM 的可修复老化测试系统，可以满足存储原厂对 DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5X 的老化测试需求。通过测试设备的全面自主开发，公司有效保障了在 NAND Flash 类存储芯片、DRAM 类存储芯片等领域的测试能力。同时，通过多年产品的开发、测试、应用循环迭代，公司在上述自

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

	主平台上积累了丰富的产品与芯片测试算法库，有效保障了存储芯片的交付质量，提升了公司整体解决方案的竞争力。
附件清单	见附件
日期	2026年1月19日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

附件：

序号	公司	姓名
1	博时基金	戴嘉佑
2	博时基金	高鑫
3	博时基金	许炯东
4	财通证券	唐佳
5	东方阿尔法	朱黎斌
6	东吴证券	谢文嘉
7	方正证券	金晶
8	个人投资者	张琳
9	广发基金	陈少平
10	国金证券	应明哲
11	国金证券	周焕博
12	国联民生证券	王海
13	国泰海通资管	李煜
14	国信证券	李书颖
15	华泰证券	张皓怡
16	华泰证券	朱昱霏
17	华西证券	李傲远
18	汇添富基金	钱晨润
19	惠升基金	田毅潇
20	交银施罗德	周珊珊
21	交银施罗德	李震琦
22	交银施罗德	王艺伟
23	金鹰基金	吴泽煌
24	景鸿永泰投资	刘恩妮
25	景顺长城	程振宇
26	景顺长城	韩非
27	景顺长城	刘煜
28	鹏华基金	吴思源
29	鹏华基金	胡颖
30	鹏华基金	张华恩
31	平安基金	高勇标
32	平安基金	陈浩宇
33	泉国基金	张家盛
34	融通基金	陈甲铖
35	申万宏源	陈俊兆
36	天辰元信	揭鹏炜
37	西格玛资产	陆宇翔
38	兴全基金	程剑

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

序号	公司	姓名
39	兴全基金	陈泓志
40	兴全基金	张荣朗沐
41	兴全基金	邹欣
42	易方达	李凌霄
43	易方达	祁禾
44	易方达	梁裕宁
45	易方达	倪春尧
46	易方达	王司南
47	易方达	杨宗昌
48	浙商证券	尹君歌
49	浙商证券	王凌涛
50	中泰证券	康丽侠
51	中信证券	郑凯航